

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-062

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司向银行申请融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币8亿元的授信额度，并为全资子公司的融资提供合计人民币不超过5亿元的担保额度。具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该决议已经2020年度股东大会批准。

近日，公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）申请流动资金贷款，融资额度为人民币2,000万元，融资期限为12个月，本次授信由实际控制人赵积清先生提供连带责任保证担保。具体贷款金额、时间及利率以双方签订的正式贷款合同为准。

华润银行东莞分行与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次融资事项在董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资关的一切事宜，无需再提交董事会审议。

二、累计综合授信额度情况

如本次交易完成后，公司及子公司已签署的融资协议涉及的累计融资金额为人民币54,000万元，本次融资事项在董事会审批额度内，由董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资关的一切事宜，无需再提交董事会审议。

三、交易目的及对公司的影响

公司进行项目融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、珠海华润银行股份有限公司授信批复

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年6月21日